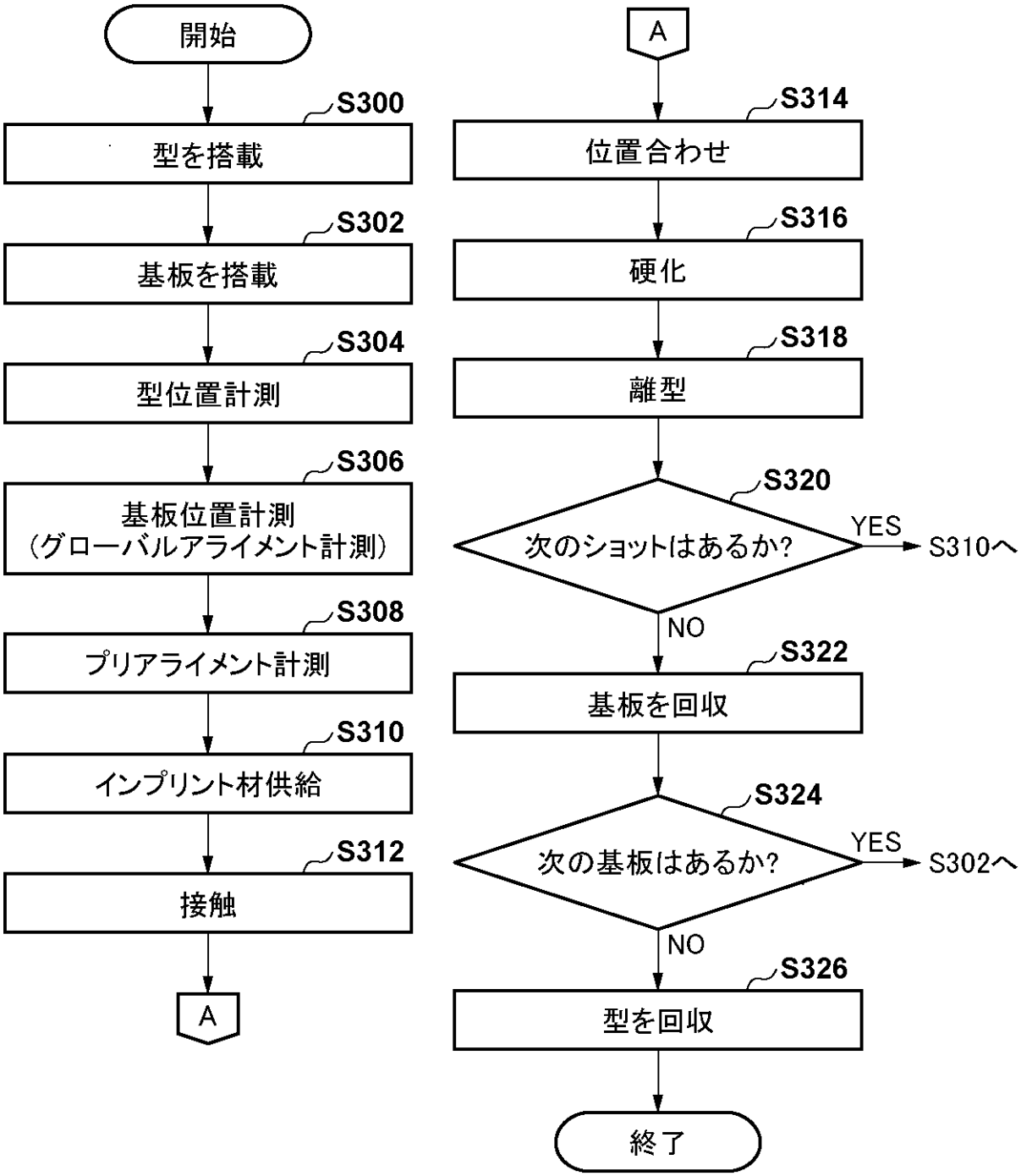
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和5年1月26日(2023.1.26)

【公開番号】特開2021-114560(P2021-114560A)
【公開日】令和3年8月5日(2021.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2021-035
【出願番号】特願2020-7017(P2020-7017)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 21/027(2006.01)
Ｂ２９Ｃ 59/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 21/30 ５０２Ｄ
Ｂ２９Ｃ 59/02 Ｚ

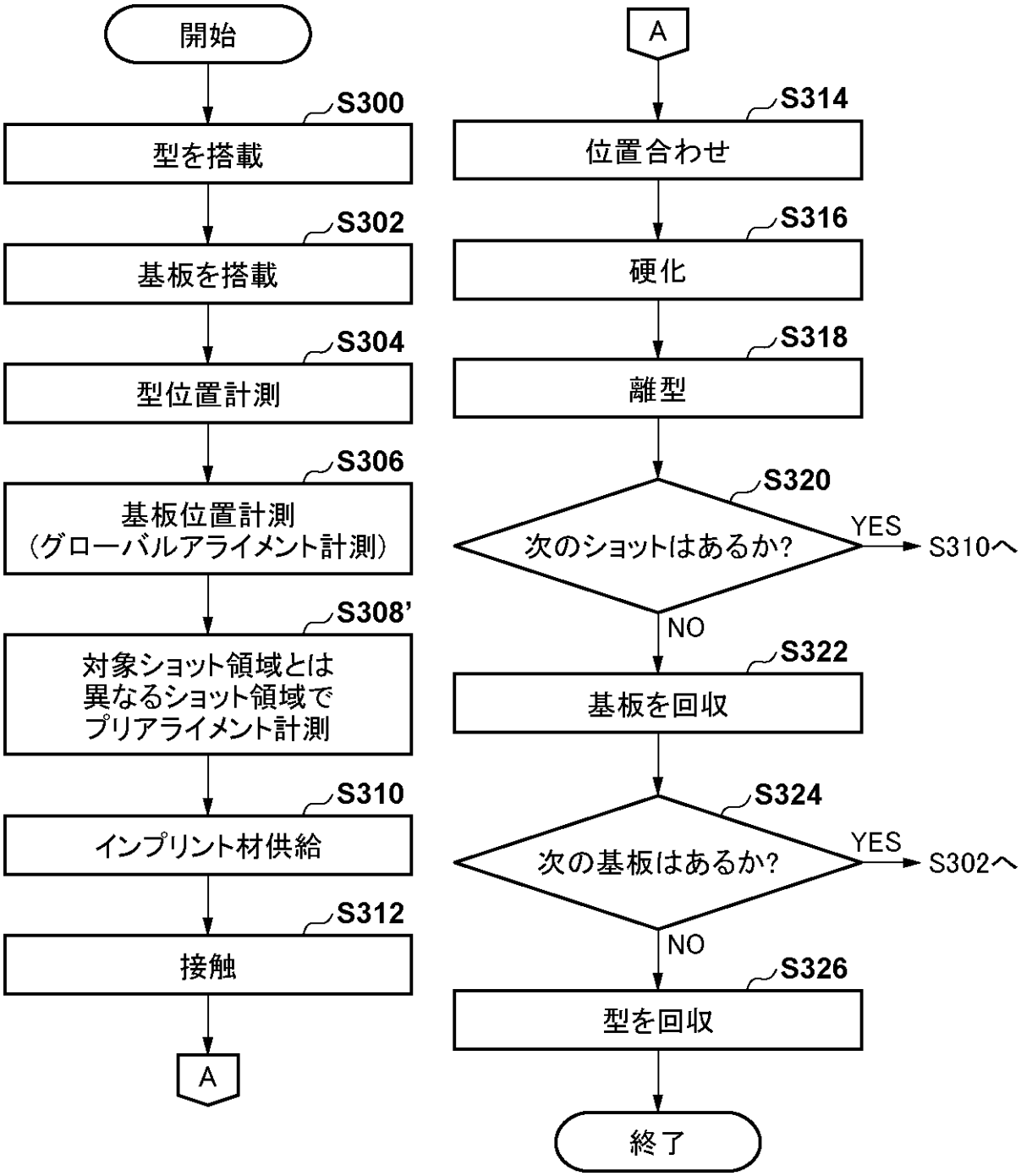
【手続補正書】
【提出日】令和5年1月17日(2023.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
Ｓ３２２で、制御部１０７は、基板搬送機構を制御して、基板チャック１１９上に載置されているインプリント処理済みの基板１１１を回収する。Ｓ３２４で、制御部１０７は、次に処理すべき基板があるかどうかを判定する。次に処理すべき基板がある場合、処理はＳ３０２に戻り、次の基板についてインプリント処理が行われる。次に処理すべき基板がない場合、処理はＳ３２６に移行する。Ｓ３２６で、制御部１０７は、型搬送機構を制御して、型チャック１１５に保持されている型１０８を回収する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図２】



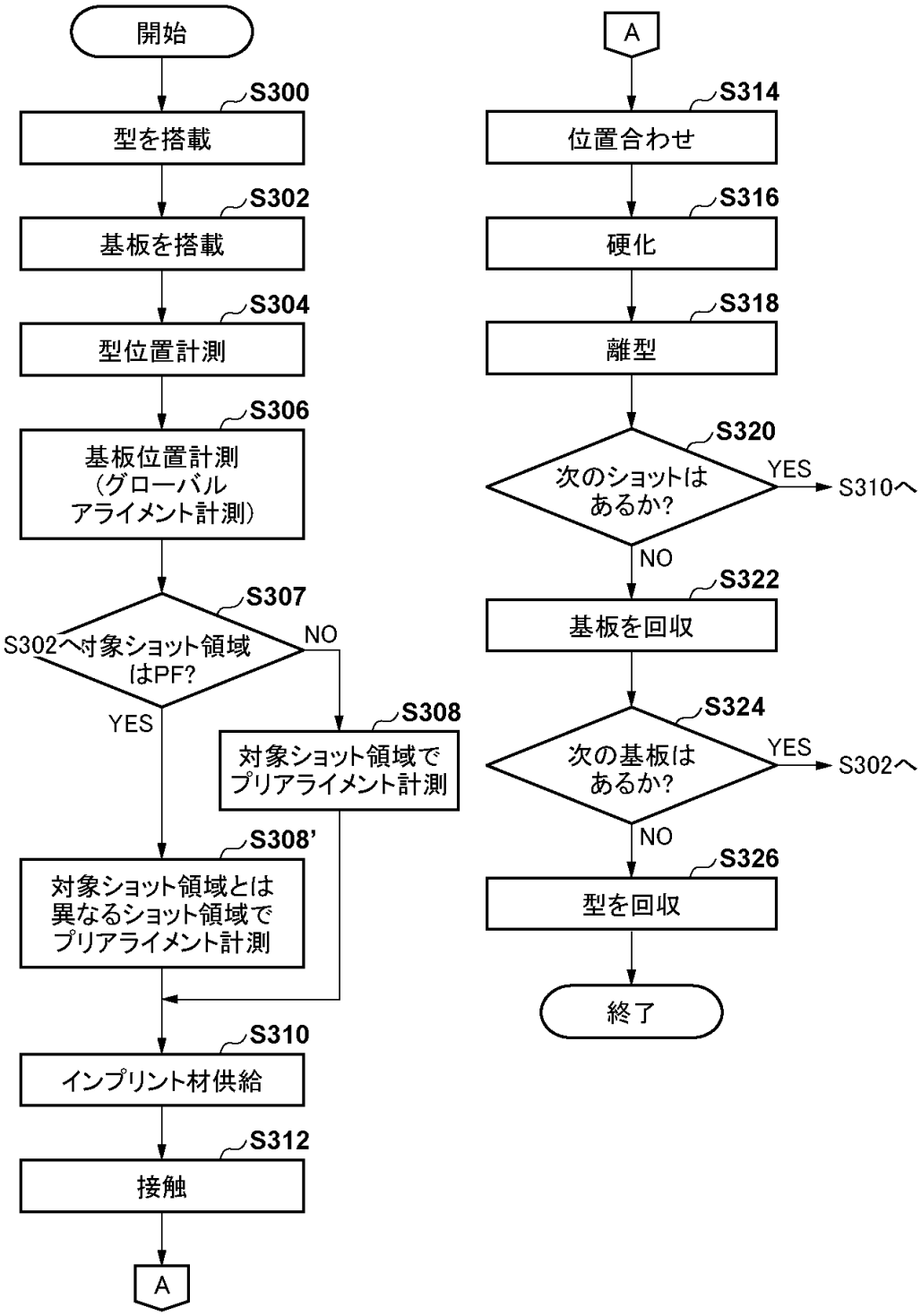
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図７】



【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図８】


開始
S300
型を搭載
S302
基板を搭載
S304
型位置計測
S306
基板位置計測
(グローバル
アライメント計測)
S307
S302へ対象ショット領域
はPF?
NO
YES
S308
対象ショット領域で
プリアライメント計測
S308'
対象ショット領域とは
異なるショット領域で
プリアライメント計測
S310
インプリント材供給
S312
接触
A
A
S314
位置合わせ
S316
硬化
S318
離型
S320
次のショットは
あるか?
YES
S310へ
NO
S322
基板を回収
S324
次の基板は
あるか?
YES
S302へ
NO
S326
型を回収
終了